



Since 1946  
Brightening the Future

# 2024年度(2025年3月期) 第1四半期決算概要について

新光電気工業株式会社



# 目次

## 2024年度 第1四半期決算概要（連結）

決算概況	2
プラスチックパッケージ	6
メタルパッケージ	8
部門別売上高	10

## 2024年度 上期・通期の見通し（連結）

売上高・損益	11
--------	----

## 2024年度 設備投資額・減価償却費・研究開発費

	13
--	----

# 2024年度 第1四半期決算概要（連結）

## 決算概況

（単位：億円）

	2023年度 1 Q	2024年度 1 Q	前年同期比	
				増減率
売上高	492	534	+42	8%
営業利益 (営業利益率)	37 (8%)	73 (14%)	+36	96%
経常利益 (経常利益率)	56 (11%)	69 (13%)	+13	24%
純利益※ (純利益率※)	37 (7%)	50 (9%)	+13	36%

※ 親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益	27.04円	36.70円
-------------	--------	--------

# 2024年度 第1四半期決算概要（連結）

## 概況

- 半導体業界は、大幅に需要を拡大したAI向けを除き、パソコン、サーバー、自動車向け等が低調に推移したことに加え、スマートフォンの買い替えサイクル長期化や在庫調整の影響などにより、半導体業界全体の回復には至らない状況が継続。
- 当社グループにおいては、セラミック静電チャックは半導体製造装置向けに売上が増加し、プラスチックBGA基板は先端メモリー向けの受注が増加。フリップチップタイプパッケージは、サーバー向けの需要回復の遅れや競争激化などの影響を受けたものの、為替相場における円安の進行などにより、売上は前年並みとなった。
- 前年同期比で売上高8%増、為替相場における円安の進行等により、各利益とも増益。

# 2024年度 第1四半期決算概要（連結）

## セグメント別売上高・経常利益

（単位：億円）

セグメント		2023年度 1Q		2024年度 1Q		前年同期比 増減率 (%)	2023年度	
			構成比(%)		構成比(%)			構成比(%)
売上高 ※1	プラスチックパッケージ	299	(61)	323	(61)	8	1,278	(61)
	メタルパッケージ	172	(35)	189	(35)	10	739	(35)
	その他	21	(4)	21	(4)	2	83	(4)
	合計	492	(100)	534	(100)	8	2,100	(100)
経常利益 ※2	プラスチックパッケージ	26	(9)	38	(12)	46	118	(9)
	メタルパッケージ	45	(26)	46	(24)	3	161	(22)
	その他/調整額	△15		△15			△7	
	合計	56	(11)	69	(13)	24	273	(13)

※1 外部顧客への売上高

※2 セグメント間取引調整前の経常利益

# 2024年度 第1四半期決算概要（連結）

## 財政状態、設備投資・減価償却費等

（単位：億円）

	2023年度 1 Q	2024年度 1 Q
総資産	3,858	3,973
純資産	2,519	2,704
自己資本比率	65%	68%

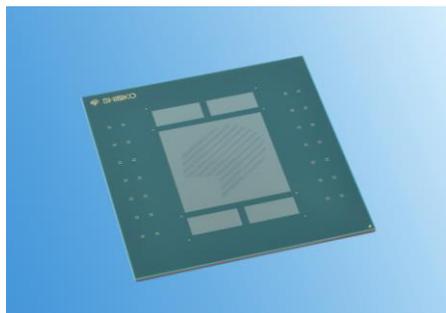
2023年度
3,938
2,650
67%

設備投資額 ※	165	80
減価償却費 ※	62	58
研究開発費	8	10
為替レート(1米ドル)	136円	153円

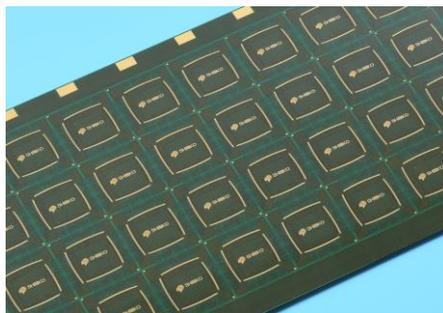
637
274
35
143円

※ 無形固定資産を除く

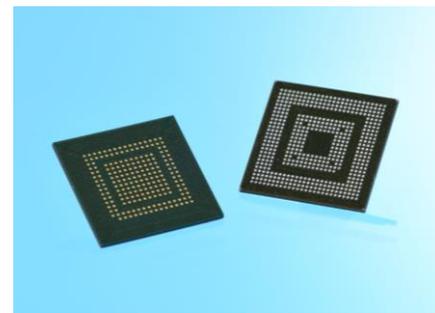
## プラスチックパッケージ



フリップチップタイプ  
パッケージ



プラスチックBGA基板



IC組立

### 【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

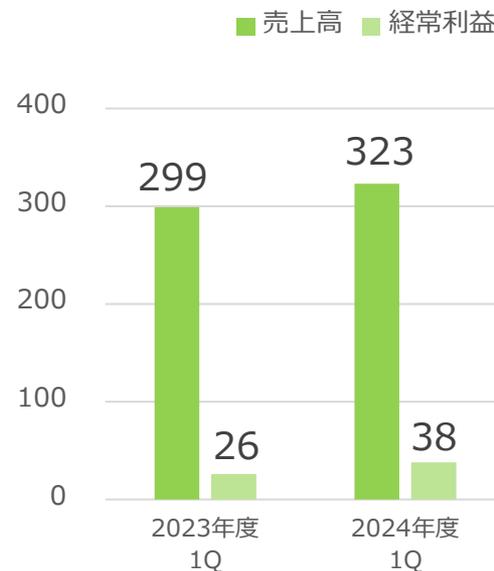
# 2024年度 第1四半期決算概要（連結）

## プラスチックパッケージ

（単位：億円）

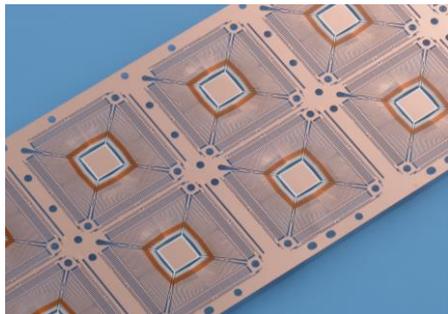
	2023年度 1 Q	2024年度 1 Q	前年同期比	
				増減率
売上高（構成比）	299 (61%)	323 (61%)	+24	8%
経常利益（経常利益率）	26 ( 9%)	38 (12%)	+12	46%

- フリップチップタイプパッケージは、サーバー向けの需要回復の遅れや競争激化などの影響を受けたものの、為替相場における円安の進行などにより、売上は前年並み
- プラスチックBGA基板は先端メモリ向けに受注が増加し増収
- IC組立はハイエンドスマートフォン向けの需要が増加し増収

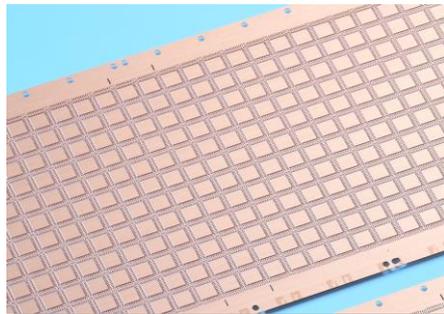


# 2024年度 第1四半期決算概要（連結）

## メタルパッケージ



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム  
(QFNタイプ)



セラミック静電チャック



ガラス端子



ヒートスプレッダー

### 【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、民生機器、半導体製造装置、通信機器 他

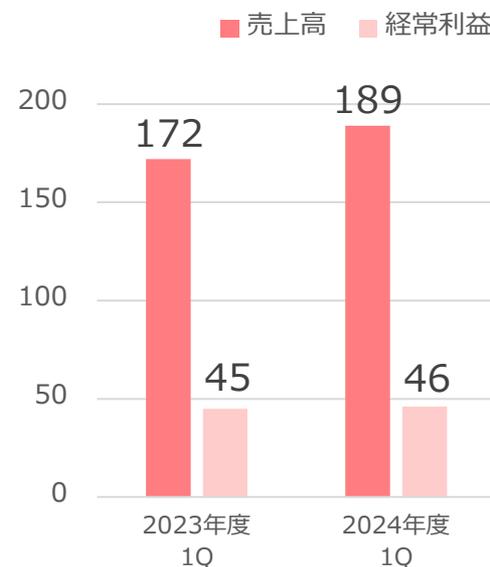
# 2024年度 第1四半期決算概要（連結）

## メタルパッケージ

（単位：億円）

	2023年度 1 Q	2024年度 1 Q	前年同期比	
				増減率
売上高（構成比）	172（35%）	189（35%）	+17	10%
経常利益（経常利益率）	45（26%）	46（24%）	+1	3%

- セラミック静電チャックは半導体製造装置向けに売上が増加
- ガラス端子は光学機器向けに受注が増加
- リードフレームは在庫調整の影響を受けたものの、為替相場における円安の進行により増収
- CPU向けヒートスプレッダーはパソコン・サーバー向けの需要が低迷し減収



# 2024年度 第1四半期決算概要（連結）

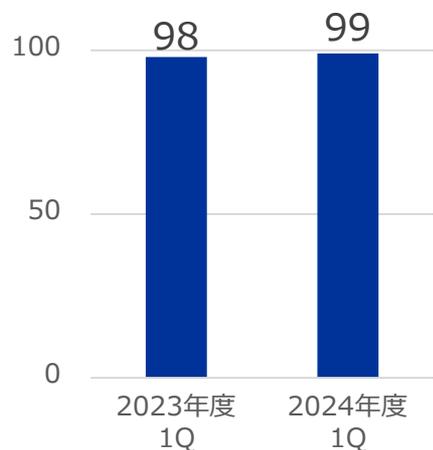
## 部門別売上高

（単位：億円）

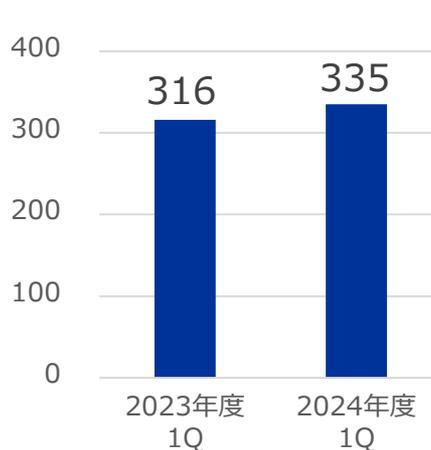
	2023年度 1 Q	2024年度 1 Q	前年同期比		2023年度
				増減率	
ICリードフレーム	98 (20%)	99 (18%)	+1	1%	389 (18%)
ICパッケージ	316 (64%)	335 (63%)	+20	6%	1,336 (64%)
気密部品	79 (16%)	100 (19%)	+21	27%	375 (18%)

※（ ）は構成比

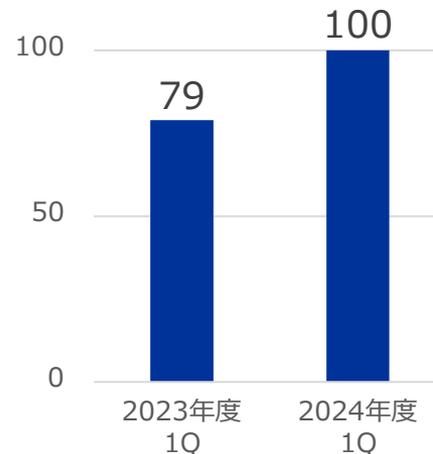
ICリードフレーム部門売上高



ICパッケージ部門売上高



気密部品部門売上高



# 2024年度 上期・通期の見通し（連結）

## 売上高・損益

（単位：億円）

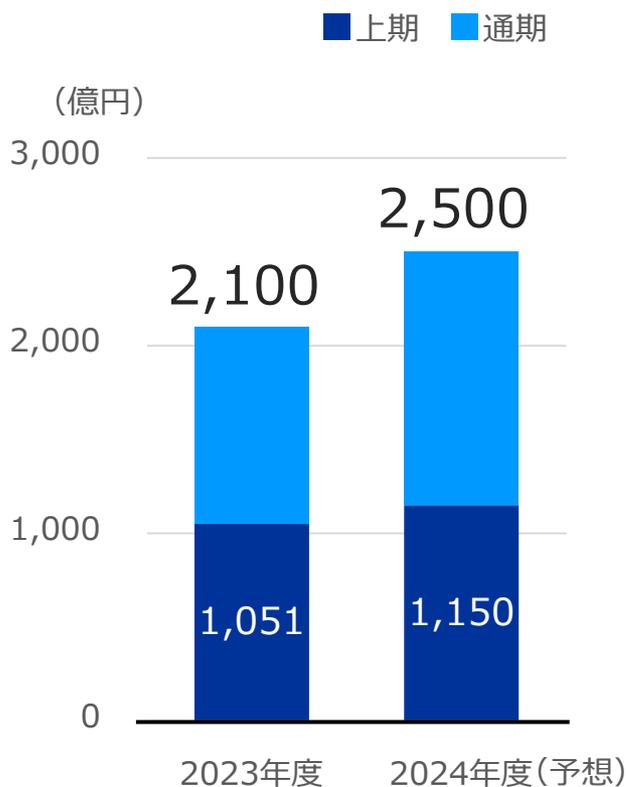
	2023年度（実績）			2024年度（予想）			前年同期比（上段：増減金額、下段：増減比率）		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	下期	通期
売上高	1,051	1,049	2,100	1,150	1,350	2,500	99 (9%)	301 (29%)	400 (19%)
営業利益 (営業利益率)	115 (11%)	133 (13%)	248 (12%)	160 (14%)	280 (21%)	440 (18%)	45 (39%)	147 (110%)	192 (77%)
経常利益 (経常利益率)	141 (13%)	132 (13%)	273 (13%)	160 (14%)	290 (21%)	450 (18%)	19 (14%)	158 (120%)	177 (65%)
純利益※1 (純利益率※1)	98 (9%)	88 (8%)	186 (9%)	110 (10%)	190 (14%)	300 (12%)	12 (12%)	102 (115%)	114 (61%)
為替レート	143円/\$			153 円/\$※2	135円/\$ (2~4Q想定)				

※1 親会社株主に帰属する当期純利益

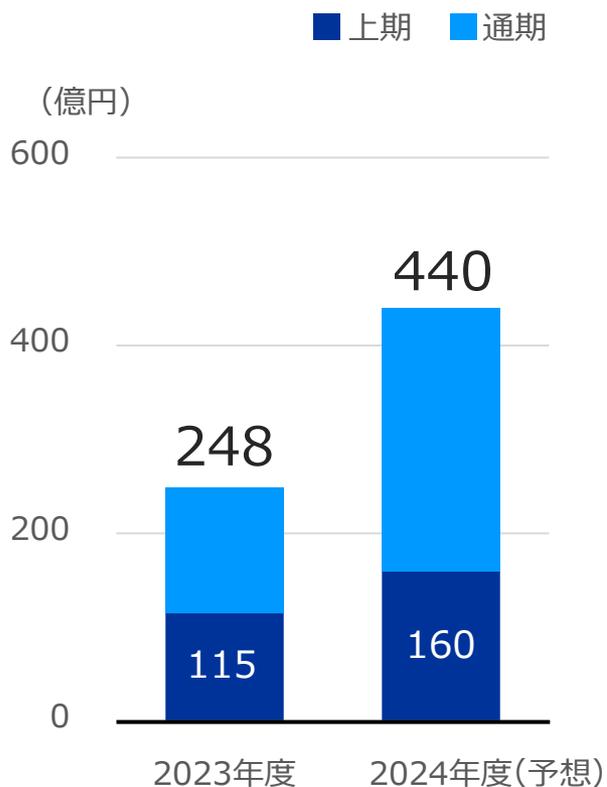
※2 2024年度1Q実績

# 2024年度 上期・通期の見通し（連結）

## 売上高

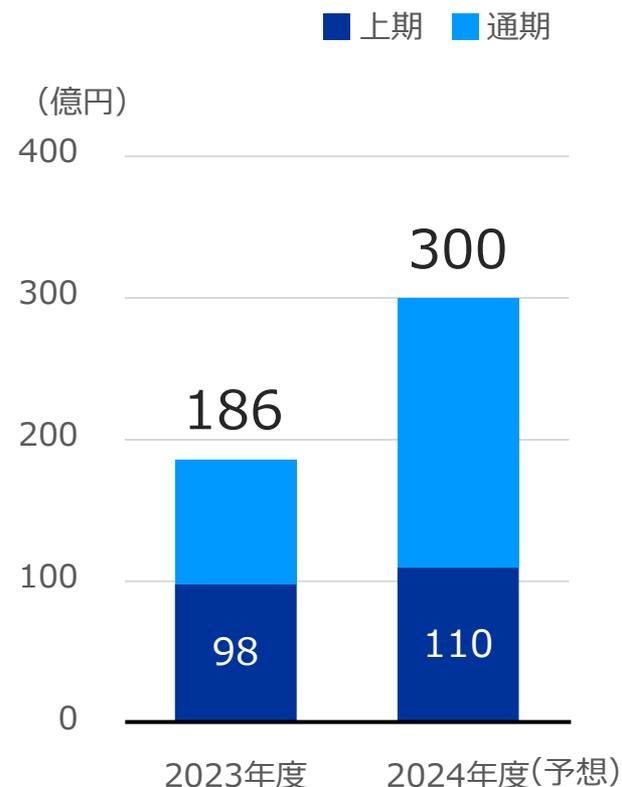


## 営業利益



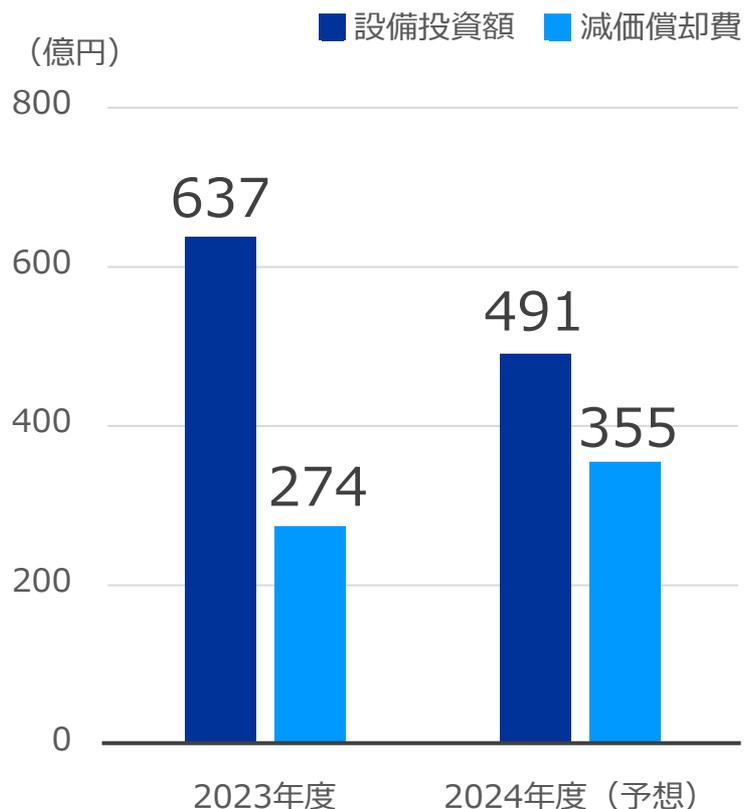
## 純利益※

※親会社株主に帰属する当期純利益

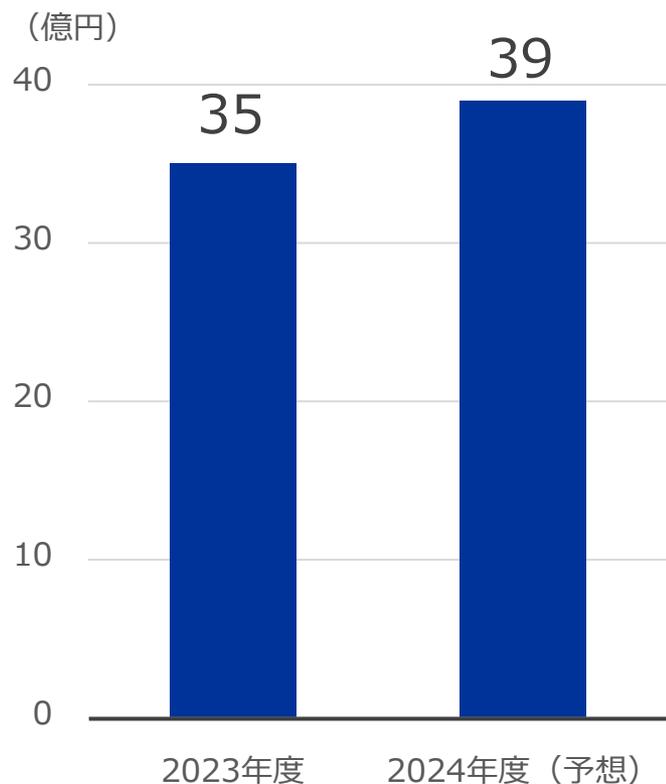


# 2024年度 設備投資額・減価償却費・研究開発費

## 設備投資額・減価償却費



## 研究開発費



本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信を参照していただきますようお願いいたします。